**附件一、「TSIA半導體設備創新獎」申請表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請編號  (**由本會填寫)** |  | 申請日期  (西元年/月/日) |  |

**一、個人或代表人基本資料：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 | (中文) | | | |
| (英文) | | | |
| 系所名稱 | (中文) | | | |
| (英文) | | | |
| 申請人 | (中文姓名) | | | (英文姓名) |
| 身份證字號 |  | 生日 | 西元 年 月 日 | |
| 戶籍地址 |  | | | |
| 通訊地址 | (含6碼郵遞區號) | | | |
| 電話 | (市話)  (手機) | Email |  | |

**二、學歷狀況：(個人申請請依最高學歷往下填寫)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 學位 | 學校 | 科系 | 修習期間  (西元年/月~西元年/月) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**三、工作經歷：(個人申請若有請填寫，並依最近工作經歷往下填寫)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任職公司 | 部門/職位 | 工作內容 | 任職期間  (西元年/月~西元年/月) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**四、團隊成員：(團隊申請請填寫，含申請者最多四人)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 學校/系所 | 學歷/學位 | 姓名 | 團隊中角色說明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**五、研究績效(含論文著作、專利發明、軟體、產品、產學合作、獲獎紀錄等)，依重要性排序，最多8項，每項扼要敘述最多5行。**

**1.**

**2.**

**3.**

**.**

**.**

**六、可供徵詢之專家資料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 服務單位/職稱 | 電話(公司/手機) | Email | 與申請者  之關係 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**七、自傳或團隊介紹(500字內)**

|  |
| --- |
|  |

**八、自述研究成果或貢獻及其重要性(500字內，請與“四、研究績效”之項目順序相符，並可將相關項目合併陳述其整體之貢獻與重要性)**

|  |
| --- |
|  |

**九、身份證及學生證正反面影本**

|  |  |
| --- | --- |
| **身份證正面黏貼處** | **身份證反面黏貼處** |
| **身份證正面黏貼處** | **身份證反面黏貼處** |
| **身份證正面黏貼處** | **身份證反面黏貼處** |
| **身份證正面黏貼處** | **身份證反面黏貼處** |
| **學生證正面黏貼處** | **學生證反面黏貼處** |
| **學生證正面黏貼處** | **學生證反面黏貼處** |
| **學生證正面黏貼處** | **學生證反面黏貼處** |
| **學生證正面黏貼處** | **學生證反面黏貼處** |

**十、應備文件點檢表：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 請打”v” | 文件名稱 |
| 10-1 |  | 申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。 |
| 10-2 |  | 推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。 |
| 10-3 |  | 身份證正反面影本各乙份(請貼於本申請表)。 |
| 10-4 |  | 工作服務證明正本。 |
| 10-5 |  | 取得博士學位後，參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。 |
| 10-6 |  | 請連結網址 <https://forms.gle/dorE7duo7nhRwwqi8>  ，填寫基本資料，並將10-1~10-5文件掃瞄為單一PDF檔案後上傳，以利建檔。 |